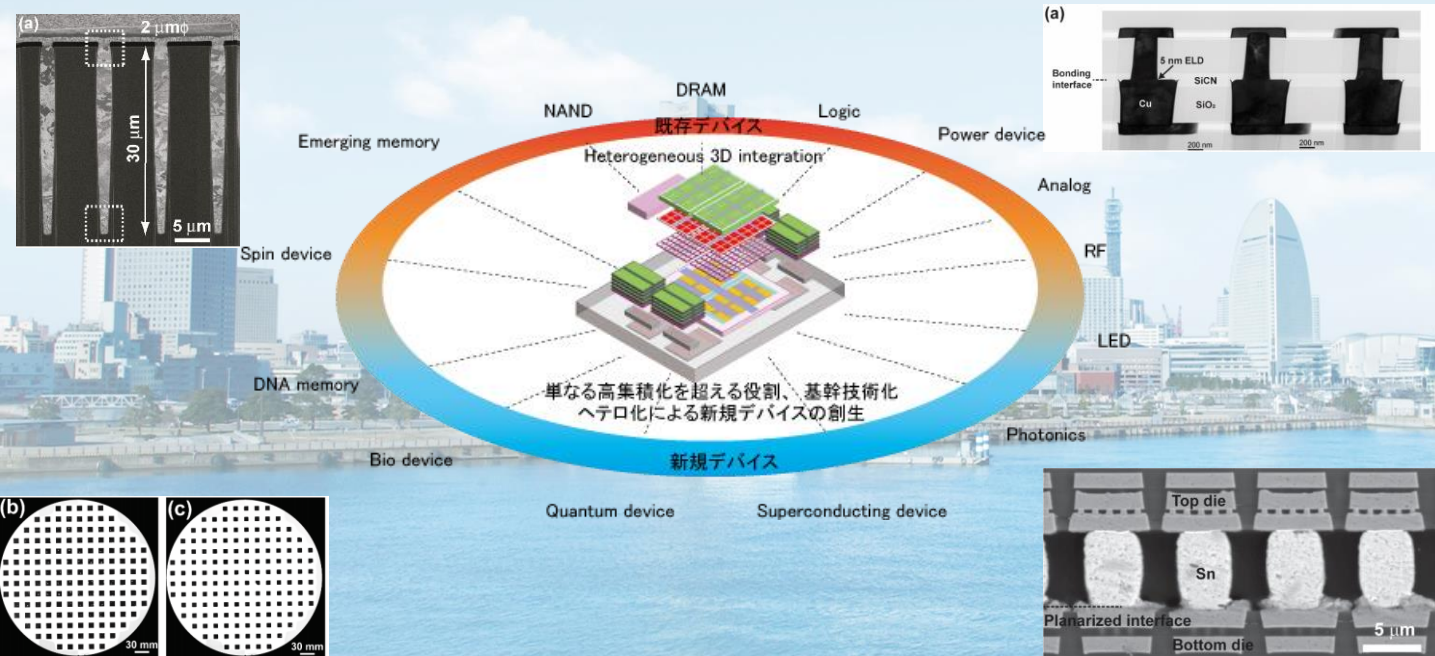


# 三次元実装プレ研究会

—三次元実装と先端パッケージングを展望する—

## HIYA: Heterogeneous Integration, YOKOHAMA Alliance



### 目的と概要

日本の半導体産業再活性化のキーワードになると期待されている3Dヘテロデバイスに関する産官学共同の研究会(HIYA:Heterogeneous Integration, YOKOHAMA alliance)の結成を目指し、プレ研究会を開催いたします。

本研究会はベルギーのimecで研究実績を積み上げ、本年4月に横浜国大准教授に就任した井上史大先生を中心に、3Dヘテロデバイスの形成とそのプロセスをテーマに産官学連携の活動を行い、半導体装置・材料メーカーに対する研究開発貢献・情報提供を行うことを基本理念とします。関心を持つ国内外の大学、官民研究組織、企業が連携して半導体産業に貢献することを目指します。

プレ研究会参加の皆様からのご意見、ご要望を賜りたいと考えます。

主催

よこはま高度実装技術コンソーシアム  
(事務局 特定非営利活動法人YUVEC)

日時

2021年11月30日(火) (14時30分~18時)

開催場所

Zoom開催とし、後日参加者にURLをご案内します。

講演者

井上史大 (横浜国立大学准教授)  
小柳光正 (東北大学名誉教授)  
満倉一行 (昭和電工マテリアルズ)  
Alain Phommahaxay (imec)

時間	講演者	講演内容
14:30 ~ 14:45	井上史大 (横浜国立大学准教授)	開会ご挨拶とHIYAアナウンス1 (日本語) HIYA研究会計画について
14:45 ~ 15:45	小柳光正 (東北大学名誉教授)	システムイノベーションの鍵を握る三次元ヘテロ集積化技術
15:45 ~ 16:35	満倉一行 (昭和電工マテリアルズ)	企業連携による半導体パッケージ評価プラットフォーム
	Break	
16:50 ~ 17:00	Fumihito Inoue (Yokohama National University)	Announcement of HIYA (English)
17:00 ~ 17:50	Alain Phommahaxay (imec)	The increasing use of WLP technology : from classical packaging activities to future CMOS node manufacturing
17:50 ~ 18:00	Fumihito Inoue	Closing and Q&A (日本語 or English)

**\*参加お申込みはホームページ (URL <http://y-jisso.org/>または<https://yuvec.org/>) のお知らせページからお願いします。**

\*通信制限で支障のある方は下記の必要事項を記入し、e-mail またはFAXでお申込み下さい。

\*申込者の個人情報(YJC, HIYA, YUVECが個人情報保護方針に基づいて厳正に管理し、皆様との適正なご連絡・ご案内に利用いたします。

【定員/締切日】定員は60といたします。申し込み締め切り日： 2021年 11月26 日(金)

(ご注意：e-mail addressの記入がありませんとURLのご案内ができません)

【お申し込み記載事項】氏名 (ふりがな) :

組織名 (ふりがな) :

所属 (役職) :

住所 :

電話 :

**e-mail(必須) :**

情報入手先： (  に  を入れてください。複数選択可 )

井上先生、  YJCのHP、  YJC (またはYUVEC) のメール連絡、  その他 ( )

\*お預かりした個人情報は三次元実装研究会、YJC、YUVECが事務局であるYUVECの「個人情報保護方針」 (<https://www.yuvec.org/privacypolicy/>) に基づき適正に管理し、本件に関わる事務連絡や今後のご案内に使わせていただきます。

## お問い合わせ

特定非営利活動法人YUVEC 事務局 島内 秀

電話：045-340-3981、FAX:045-340-3982

e-mail: [yuvec02@ml.ynu.ac.jp](mailto:yuvec02@ml.ynu.ac.jp)

住所：〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5

横浜国立大学共同研究推進センター1F